



(10) **AT 512859 A3 2015-05-15**

(12)

Recherchenbericht

(Österreichische Patentanmeldung)

(21) Anmeldenummer: A 382/2013
 (22) Anmeldetag: 07.05.2013
 (88) Recherchenbericht
 veröffentlicht am: 15.05.2015

(51) Int. Cl.: **H01L 21/67** (2006.01)
H01L 23/00 (2006.01)

(30) Priorität:
 11.05.2012 KR 10-2012-0050068 beansprucht.
 27.09.2012 KR 10-2012-0108058 beansprucht.

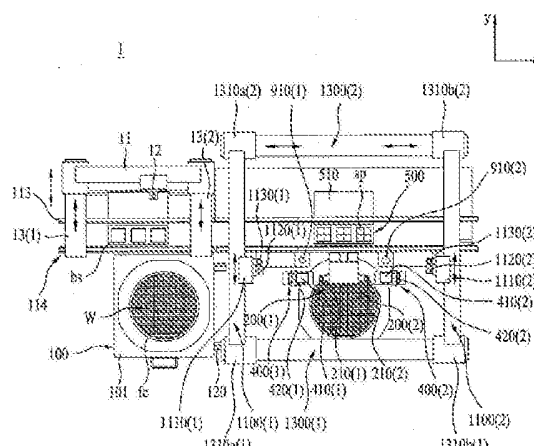
(56) Entgegenhaltungen:
 US 5839187 A
 US 2003177633 A1
 US 2003110623 A1
 US 2007145102 A1

(71) Patentanmelder:
 Hanmi Semiconductor, Co., Ltd.
 404-250 Incheon (KR)

(74) Vertreter:
 Haffner und Keschmann Patentanwälte GmbH
 Wien

(54) Halbleiterchip Wende- und Befestigungseinrichtung

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Flip-Chip-Bondvorrichtung, welche die Genauigkeit und Zuverlässigkeit eines Überföhrungsprozesses zum Überföhren eines bei einem Flip-Chip-Bondprozess verwendeten Bondkopfs zu einer vorgegebenen Position auf der xy-Ebene verbessern kann, die Überföhrungsoperation von Überföhrungsstrecken für das Überföhren jedes Bondkopfs minimieren kann und das Problem des durch Wärme erzeugten Positionsfehlers abmildern kann. Insbesondere betrifft die vorliegende Erfindung eine Flip-Chip-Bondvorrichtung, welche die Anzahl der Bewegungen und den Bewegungsabstand eines Bondkopfs in einer spezifischen Achsenrichtung verringern kann, die thermische Ausdehnung und Vibrationen infolge der Überföhrung des Bondkopfs verringern kann und den UPH-Wert der Vorrichtung verbessern kann, während eine ausreichende Zeit für das Abflachen des Flussmittels sichergestellt wird.



Klassifikation des Anmeldungsgegenstands gemäß IPC:
H01L 21/67 (2006.01); **H01L 23/00** (2006.01)

Klassifikation des Anmeldungsgegenstands gemäß CPC:
H01L 21/67144 (2013.01); **H01L 24/75** (2013.01); **H01L 24/81** (2013.01)

Recherchierter Prüfstoff (Klassifikation):
H01L

Konsultierte Online-Datenbank:
EPDOC; WPI

Dieser Recherchenbericht wurde zu den am **07.05.2013** eingereichten Ansprüchen **1-33** erstellt.

Kategorie ¹⁾	Bezeichnung der Veröffentlichung: Ländercode, Veröffentlichungsnummer, Dokumentart (Anmelder), Veröffentlichungsdatum, Textstelle oder Figur soweit erforderlich	Betreffend Anspruch
X	US 5839187 A (SATO SEIICHI [JP], OTAKE KENICHI [JP]) 24. November 1998 (24.11.1998) Zusammenfassung; Figuren 1-7 und die zugehörige Beschreibung	1-16
X	US 2003177633 A1 (HAJI HIROSHI [JP], HIRAKAWA TOSHIRO [JP]) 25. September 2003 (25.09.2003) Zusammenfassung; Figuren; Beschreibung	1-16
A	US 2003110623 A1 (HAJI HIROSHI [JP], HIDESE WATARU [JP]) 19. Juni 2003 (19.06.2003) das gesamte Dokument	1-33
A	US 2007145102 A1 (BLESSING PATRICK [CH], GRUETER RUEDI [CH], WERNE DOMINIK [CH]) 28. Juni 2007 (28.06.2007) das gesamte Dokument	1-33

Datum der Beendigung der Recherche:
13.02.2015

Seite 1 von 1

Prüfer(in):

HARASEK Stefan

¹⁾ **Kategorien** der angeführten Dokumente:

- X** Veröffentlichung **von besonderer Bedeutung**: der Anmel-
gegenstand kann allein aufgrund dieser Druckschrift nicht als neu bzw. auf
erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden.
- Y** Veröffentlichung **von Bedeutung**: der Anmeldungsgegenstand kann nicht
als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die
Veröffentlichung mit einer oder mehreren weiteren Veröffentlichungen
dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese **Verbindung für
einen Fachmann naheliegend** ist.

- A** Veröffentlichung, die den allgemeinen **Stand der Technik** definiert.
- P** Dokument, das von **Bedeutung** ist (Kategorien **X** oder **Y**), jedoch **nach
dem Prioritätstag** der Anmeldung veröffentlicht wurde.
- E** Dokument, das **von besonderer Bedeutung** ist (Kategorie **X**), aus dem
ein „**älteres Recht**“ hervorgehen könnte (früheres Anmeldedatum, jedoch
nachveröffentlicht, Schutz ist in Österreich möglich, würde Neuheit in Frage
stellen).
- &** Veröffentlichung, die Mitglied der selben **Patentfamilie** ist.